

UV光固化解膠膜與感壓膠

技術特色

UV前具有足夠黏著力，使物件於加工過程中不脫落、飛散。

加工結束後經由UV照射黏性降低且無殘留物，可讓微元件容易取下，本技術能依照製程和基材需求調整UV前後之黏著力。

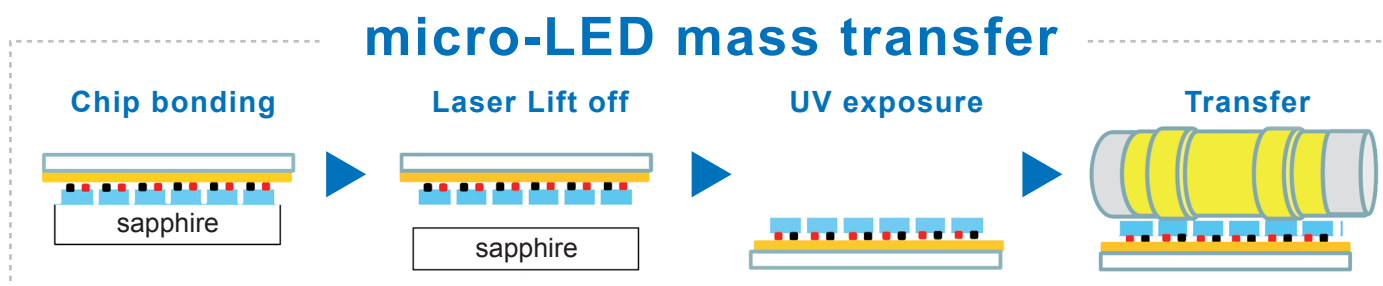
技術規格

| 特性 | | Non-UV type | UV type |
|------------------|-----|----------------------------|----------------------------|
| 基材 | | PO/EVA/PET玻璃 銅箔 不鏽鋼板 | PO/EVA/PET玻璃 銅箔 不鏽鋼板 |
| 厚度(um) | | 5~20 | 5~20 |
| 剝離力 (gf/25mm) | UV前 | 50~500 | 100~1000 |
| | UV後 | — | ≤20 |

產業應用

UV光固化解膠膜與感壓膠技術可廣泛運用於半導體產業和光電領域。

如晶圓研磨和切割、LED、面板用玻璃基板研磨切割與micro LED巨量轉移等。

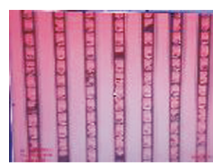


開發現況



Chips on substrate

選擇性轉移區域
(第1、4、7欄晶片被拿取後)



Chips on stamp

Chip size: 100X150μm

